高電流密度対応ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤

トップルチナHV

Additives for Acid Copper Plating to Via-filling under High Current Density

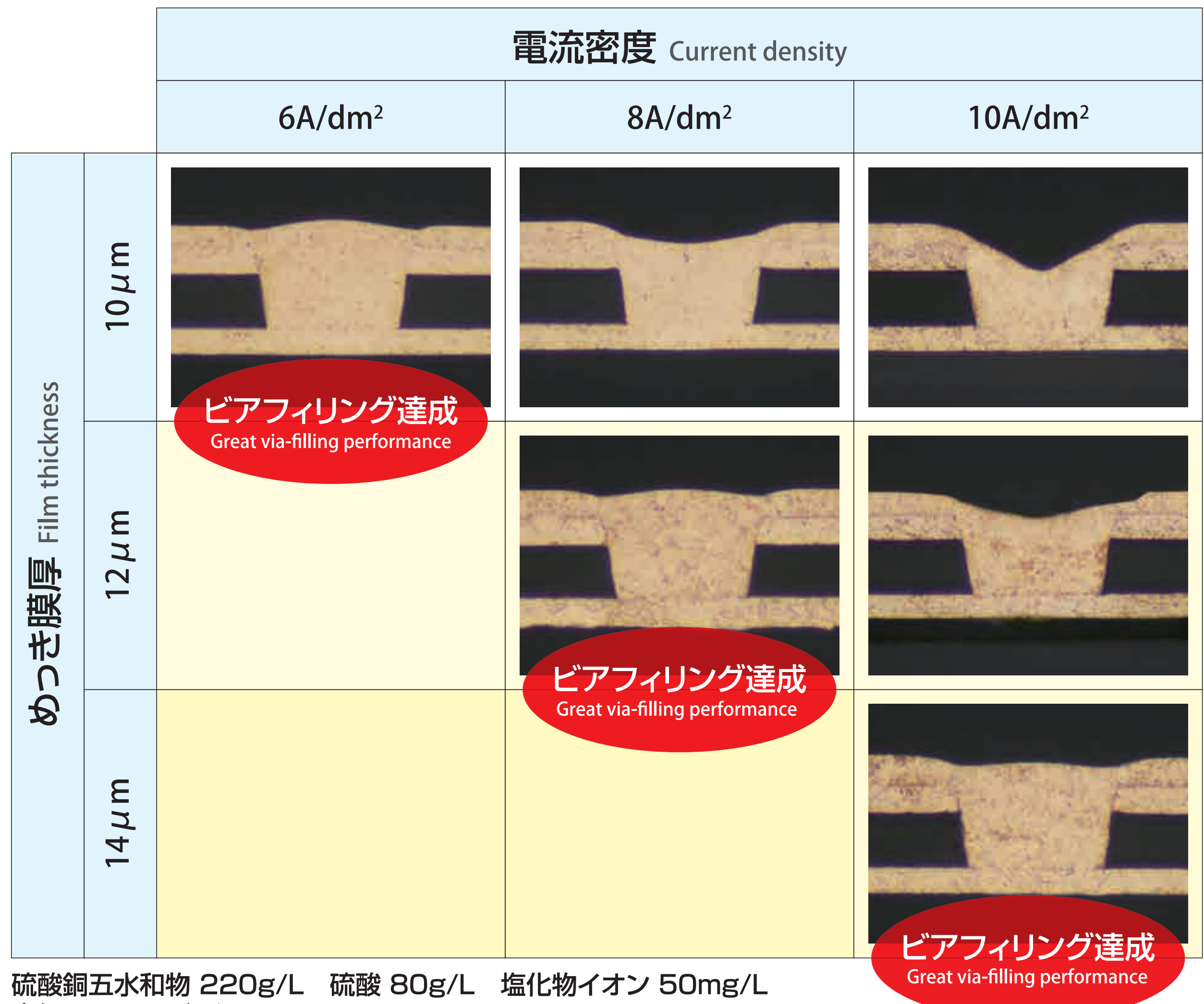
TOP LUCINA HV

- 優れたビアフィリング性能を発揮
- 幅広い電流密度(1.0～10A/dm²)に対応
- 全ての添加剤成分の定量分析が可能
- 2液構成のため、浴管理が簡便

- Can show great via-filling performance
- Applicable to wide current density (1.0 to 10 A/dm^2)
- Quantitative analysis is possible for all additives
- Use two components, easy bath control

幅広い電流密度で優れたビアフィリング性能を発揮

Can show great via-filling performance in wide current density areas



硫酸銅五水和物 220g/L　硫酸 80g/L　塩化物イオン 50mg/L
穴径 75μm, ビア深さ 50μm

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 220g/L　H_2SO_4 80g/L　Cl^- 50mg/L
Via hole diameter 75μm　Via hole depth 50μm

国内外で10社以上の採用実績

Actual production over 10 customers in Japan and overseas

縦型搬送、キャリア、Roll to Roll方式など様々なライン装置で実績有り
リジッド、フレキ、リジッドフレキなど様々な基板に適用可能

Using by vertical-conveyance, career, Roll to Roll plating system
Applicable to rigid, flexible, rigid-flexible PWBs